

檔 號：

保存年限：

## 駐慕尼黑辦事處 函

地址：Leopoldstrasse 28A/V80802 Muechen

承辦人：蔣憶萍

電話：+49-89-5126-7917

電子信箱：ypychiang@mofa.gov.tw

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國114年8月4日

發文字號：慕尼字第1144170187號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：關於德國巴伐利亞邦投資局邀請貴公司/學院/機構參與原定本（2025）年8月21日至22日在德國慕尼黑舉行「台灣-巴伐利亞AI晶片研發及應用工作坊」事，請查照。

說明：

- 一、德國巴伐利亞邦投資局結合本年11月18日至21日「歐洲國際半導體展」（SEMICON Europa）活動，接續專為我國企業及研究機關辦理旨揭工作坊，並由該邦經濟部常務次長Dr. Sabine Jarothé致函邀請貴公司/學院/機構出席。
- 二、巴伐利亞邦致力發展半導體應用於高科技如汽車、醫療及國防等之產業，針對旨揭工作坊該邦同步邀請實力雄厚之在地企業，如Audi AG、BMW AG、英飛凌科技、OSRAM Opto半導體公司、Airbus航太、萊茵金屬、Renk集團、Hensoldt Sensors公司等逾20家公司，以提升台巴（伐利亞）半導體相關產業交流互動並促民主供應鏈合作商机，同時亦將為我企業介紹巴邦投資環境及該局提供我企業之協助方案。
- 三、為因應國際地緣政治變化，德國及歐洲國家本年大幅提升國防相關等領域之預算，帶動相關尤其是高科技及半導體產業之需求，旨揭工作坊有助我商瞭解該邦供需生態，取得先機，創造雙贏契機，竭誠歡迎貴公司/學院/機構報名參與。
- 四、檢附J常務次長邀請函（併議程草案）及巴邦AI應用介紹如附件共8頁，請參考。後續相關報名與諮詢可逕與本案投資局窗口 Ms. Agata Butenko（agata.butenko@invest-in-bavaria.com）及 Mr. Jens Huefner（jens.huefner@invest-in-



bavaria.com) 取得聯繫。

正本：台灣積體電路製造股份有限公司、世界先進積體電路股份有限公司、聯發科技股份有限公司、晶心科技股份有限公司、聯詠科技股份有限公司、瑞昱半導體股份有限公司、奇景光電股份有限公司、世芯電子股份有限公司、群聯電子股份有限公司、鈺創科技股份有限公司、耐能智慧股份有限公司、臺灣發展軟體科技股份有限公司、芯知了股份有限公司、日月光半導體製造股份有限公司、力成科技股份有限公司、矽品精密工業股份有限公司、京元電子股份有限公司、國立台灣大學重點科技研究學院、國立清華大學半導體研究學院、國立陽明交通大學產學創新研究學院、國立成功大學智慧半導體及永續製造學院、國立中山大學半導體及重點科技研究學院、財團法人工業技術研究院、財團法人國家衛生研究院、社團法人台灣生醫電子工程協會(請轉知協會會員)、台灣區電機電子工業同業公會(請轉知協會會員)、台灣電路板協會(請轉知協會會員)、亞洲無人機AI創新應用研發中心(請協轉知園區企業)、雲象科技股份有限公司、廣達電腦股份有限公司、華碩電腦股份有限公司、仁寶電腦工業股份有限公司、愛因斯坦人工智慧股份有限公司、宏碁智醫股份有限公司、長佳智能股份有限公司、兆迪科技股份有限公司、群環科技股份有限公司、利像科技股份有限公司、創鑫智慧股份有限公司、筑波醫電股份有限公司、台安生物科技股份有限公司、奇翼醫電股份有限公司、國際半導體產業協會(請轉知協會會員)、台灣半導體產業協會(請轉知協會會員)

副本：外交部、數位發展部、經濟部、國家科學及技術委員會、衛生福利部、駐法蘭克福辦事處經濟組(均含附件)

電子公文  
交換章

## ——批核軌跡及意見——

